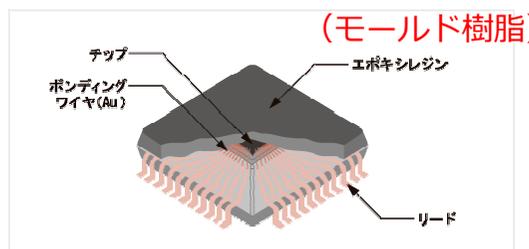
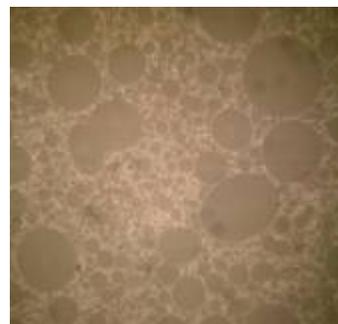


半導体 P K G 用樹脂の研磨

- 電子部品の多くは、モールド樹脂を使用しています。
この樹脂の中には、充填剤として「フィラー」と呼ばれる充填材が入っています。
樹脂のタイプによりこの形状が異なります。
また、製品の用途においても、樹脂が異なります。



A : 旧世代 : 汎用樹脂断面
→粉砕した角のある形状が目立つ



B : 低応力樹脂
→充填材の形状が球状

